

产品规格书

SPECIFICATION

客户名称：_____

产品名称：1206 翠绿色片式发光二极管

产品型号：LX15-21SUGC/A16

客户编码：_____

日期：2014-11-01

顾客确认			

顾客确认			



深圳市林欣电子有限公司
欣欣发展（香港）有限公司

SHENZHEN LINXIN ELECTRONICS CO., LTD

<http://www.szlinxin.cn>

e-mail: sales@szlinxin.cn

电话：(0755) 84859893 传真：(0755) 84857772

技术质量部		
批准	审核	制定
	李晓飞	陈丽娜

LX15-21SUGC/A16

一、 特点：

- | 管芯材料： Green 翠绿色
- | 无色透明封装
- | 3.2mm× 1.5mm× 1.1mm片式发光二极管
- | 光强高 ,功耗低 ,可靠性高 ,寿命长
- | 符合欧盟公布的 RoHS指令

二、 用途：

移动电话、 LCD背光源、 汽车仪表照明以及用表面贴装结构的电子产品等。

三、 极限参数 ($T_A=25$)：

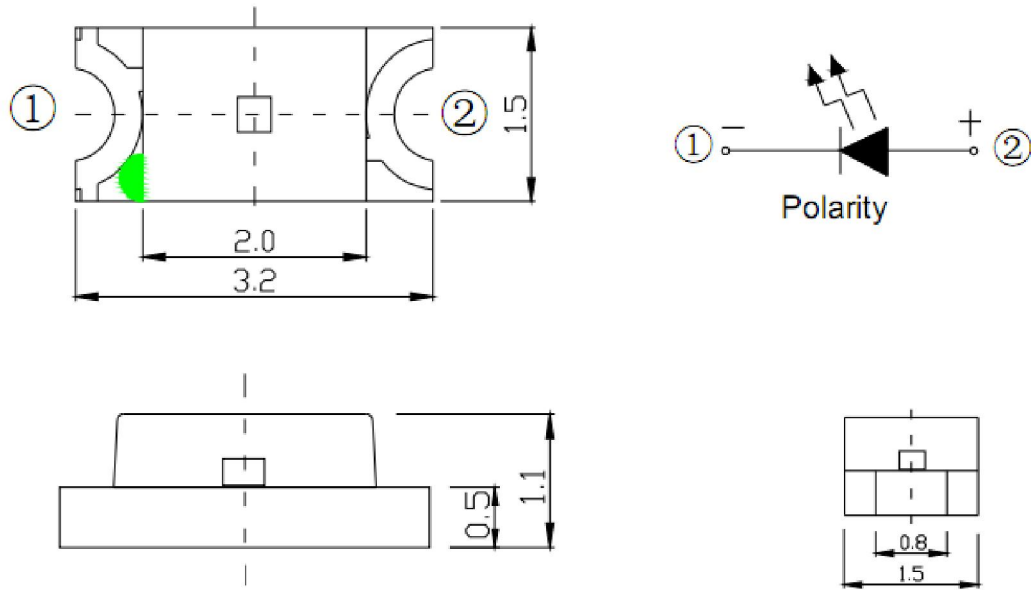
参数	最小值	最大值	单位
正向电流 I_F		25	mA
正向脉冲电流 I_{FP}^*		100	mA
反向电压 V_R		5	V
工作温度 T_{OPR}	-30	+85	
贮存温度 T_{STG}	-40	+85	
功 耗 P_D		75	mW
焊接条件 T_{sol}	回流焊： 260 ， 10S; 手动焊： 300 ， 3S		

*注：脉冲宽度 10ms, 占空比 1/10

四、 光电参数 ($T_A=25$)：

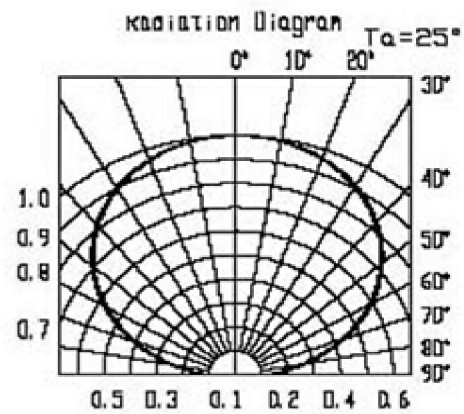
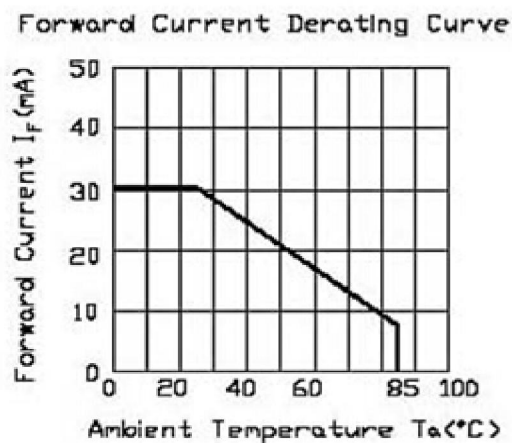
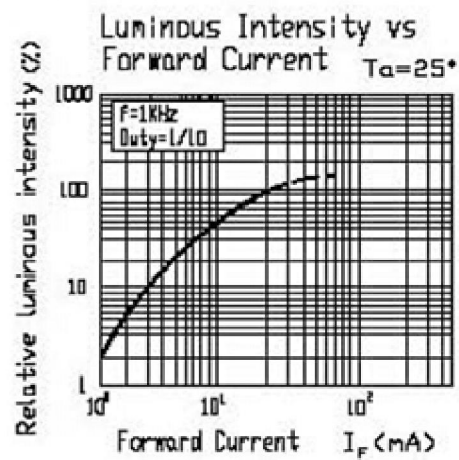
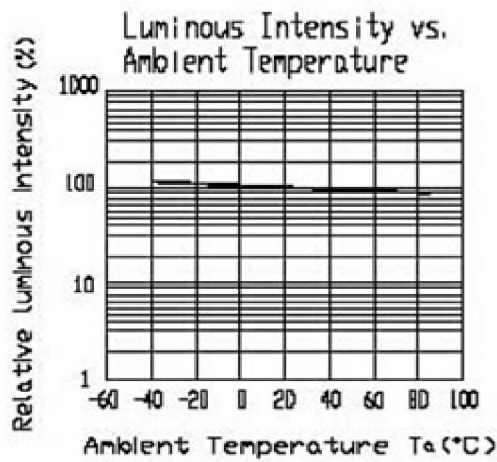
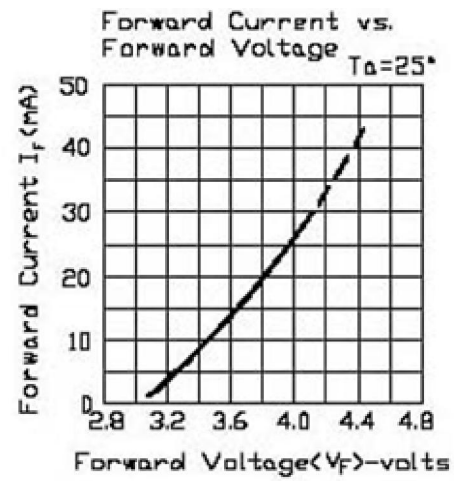
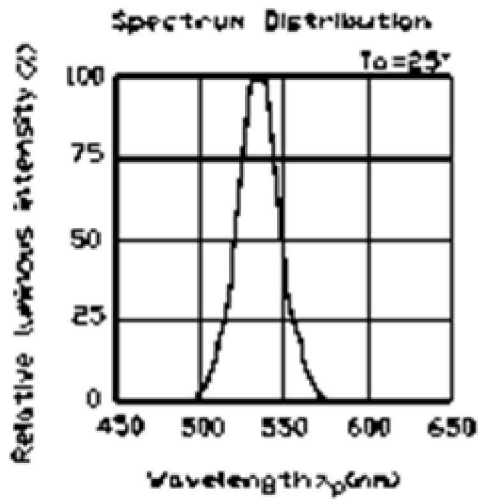
参数名称	条件	单位	最小值	中间值	最大值
正向电压 V_F	$I_F=20mA$	V	2.8		3.4
反向电流 I_R	$V_R=5V$	μA		10	
峰值波长 λ_p	$I_F=20mA$	nm	520		532
半光强视角 $2\theta_{1/2}$	$I_F=20mA$	deg		130	
光 强 I_v	$I_F=20mA$	mcd	400		700

五、外形尺寸：



公差：±0.1
单位：mm

六、特性曲线



七、可靠性试验：

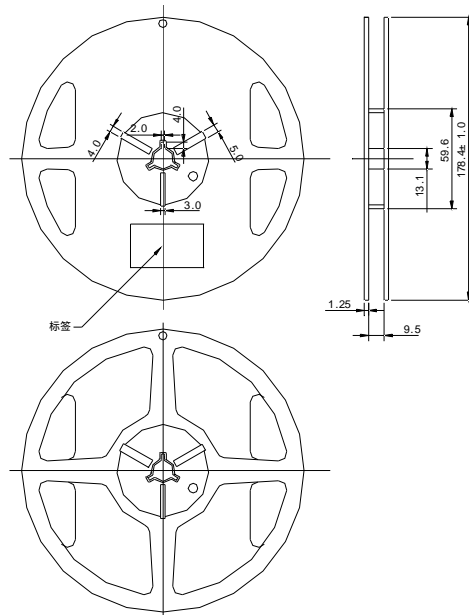
序号	试验项目	试验条件	数量	判据
1	可焊性试验	T=300 T=3.5 ± 0.5sec.	0/15	焊接面积 95%
2	温度快速变化 继之以循环湿热 (D)	T _A = - 40 , T _B = + 85 循环 5 次 , 暴露时间 :10min 转移时间 :(2~3) min T=25~55 , RH=(90~95) % 2 次循 环 48h 恢复时间 2 h	0/18	*1
3	耐焊接热试验	红外回流焊法 见图 3	0/15	*1
4	电耐久性试验	I _F =25mA T=1000h	0/15	*1
5	高温贮存试验	T= + 85 t=1000h	0/15	*1
6	循环湿热	T=25~55 , RH=(90~95) % 6 次循环 144 h 恢复时间 2 h	0/20	*1

***1 失效判断标准**

测试项目	符号	测试条件	失效判断标准
正向电压	V _F	I _F =20mA	U × 1.1
反向电流	I _R	V _R =5V	U × 2
光强	I _V	I _F =20mA	S × 0.7

八、包装：

1) 包装材料：编带（请参照图 1）

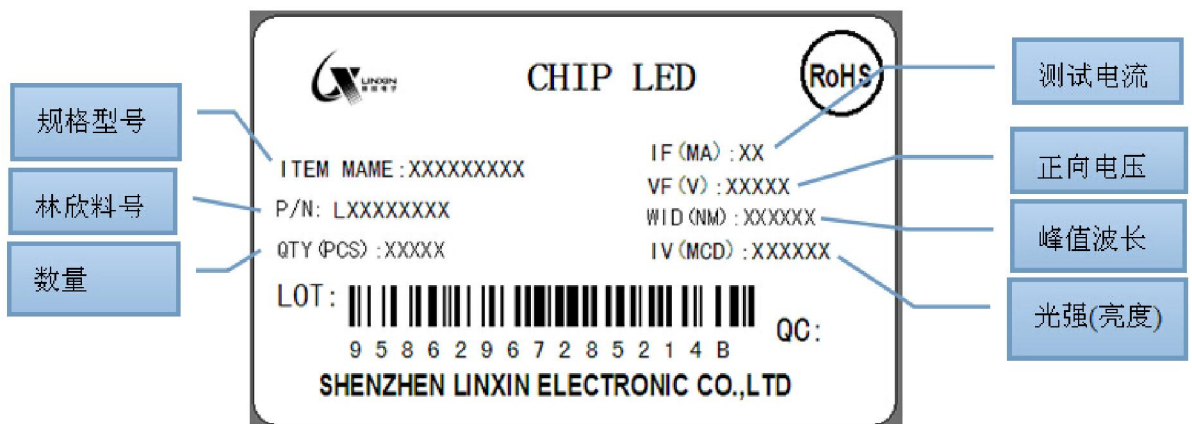


单位：MM

→
前进方向

图 1

2):料盘及包装袋标签标识：



3) SMD载带的具体细节：



4) 每编带负载数量：3,000 只（见图 2）

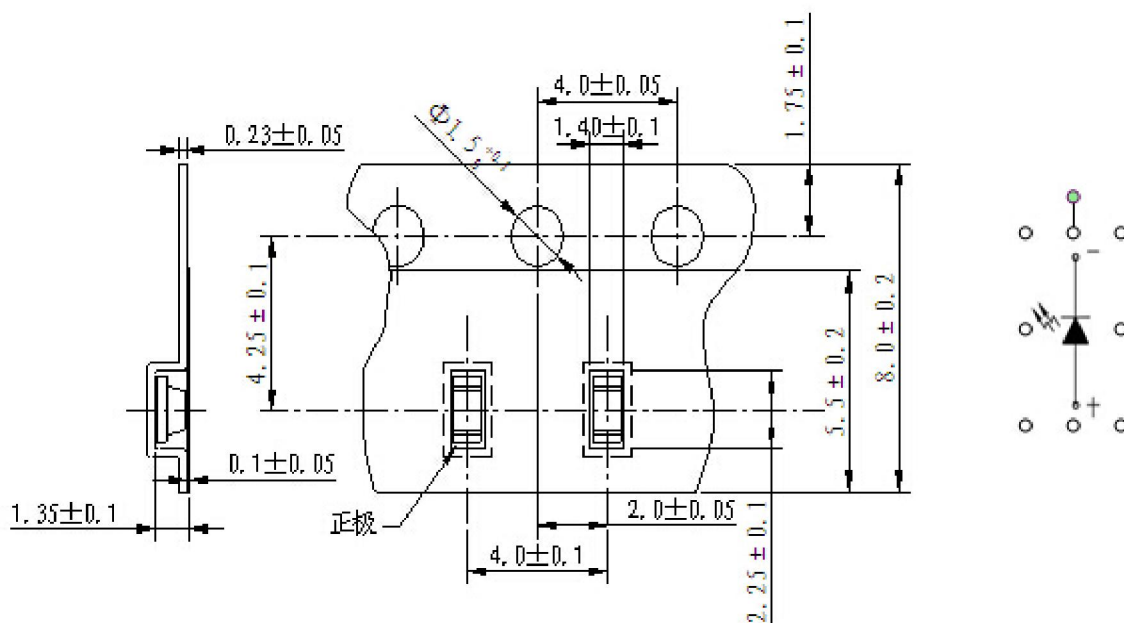


图 2

九、使用注意事项：

1) 焊接：

①使用烙铁人手焊接：

推荐使用少于 25W 的烙铁，而且烙铁的温度必须保持不高于 300℃，焊接时间不得超过 3 秒。。

②回流焊：

a. 推荐图表 3 中的温度图。回流焊焊接次数不得超过 2 次。

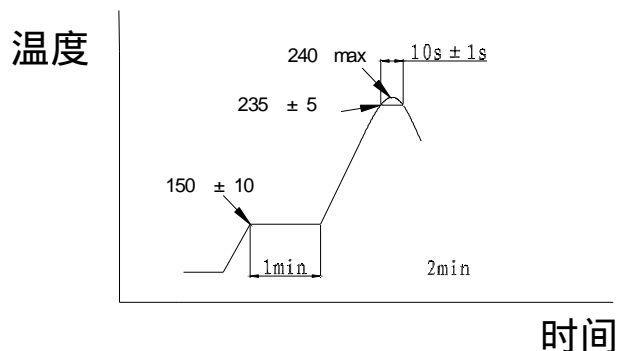


图 3

b.焊接过程中，严禁在高温情况下触碰胶体；焊接后，禁止对胶体施加外力，禁止折弯 PCB，以避免撞击 LED；在焊接后，在产品的温度下降到正常室温时，小心注意处理产品。

2)清洗：

在焊接后必须按照以下条件进行清洗。

①清洗溶剂：氟利昂 TF 或相等溶剂，或者用酒精。

②温度：30 秒 最高 50 或者 3 分钟 最高 30

③超声波清洗：最大 300W。

3)其他事项：

a. 当 SMD LED 暴露在高温状态下，注意不要压其环氧部分。

b. 注意不要使用硬物和带尖锐边的物体刮、擦 SMD LED 的环氧部分，例如喷砂设备和金属钩。因为环氧树脂是相当脆弱和容易被破坏。